

## RFスパッタ装置 SP-31000R



5インチから数mmのチップまで、多様な寸法のスパッタリングが可能です。ターゲットを大きくするとともに、良い膜厚分布を得る事の出来る構造になっています。1台のスパッタリング用電源で、3個のターゲットに対して自動切り換え印加が可能です、多層膜生成用に適しています。

### RFスパッタ装置SP-31000R仕様

|          |   |
|----------|---|
| ○到達圧力    | ×10 <sup>-5</sup> Pa台※常温・無負荷・脱ガス時   |
| ○排気速度    | ×10 <sup>-4</sup> Pa台迄10分以内※常温・無負荷・脱ガス時   |
| ○成膜室径    | φ540mm×250mmH   |
| ○スパッタ用電源 | RF電源 13.56MHz 1KW 自動マッチング 1台  |
| ○基板形状    | 5インチ 1枚   |
| ○膜厚分布    | ±10%以内  |
| ○ターゲット寸法 | 6インチ(金属・絶縁物)  |
| ○ターゲット個数 | 3   |
| ○基板回転    | 無し  |
| ○基板加熱    | 常温～200℃迄昇温可能  |
| ○真空排気系   | 油回転ポンプ:900L/min<br>メカニカルブースターポンプ:100m <sup>3</sup> /h<br>クライオポンプ:1200L/sec                                |
| ○操作方法    | 自動  |
| ○ガス系統    | マスフローコントローラ 1系統   |
| ○ユーティリティ | 電気:AC200V三相15KVA<br>冷却水:8L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環<br>計装エア:0.5MPa以上<br>設置寸法:4000mmW×2000mmD×1800mmH |